

Unternehmenspräsentation

29. Januar 2015



Infineon und International Rectifier: Eine leistungsstarke Verbindung



+



A Powerful Combination

- Seit **Januar 2015** ist International Rectifier ein Unternehmen von Infineon Technologies
- Gemeinsamer **Pro-forma-Umsatz: 5.150 Mio. EUR*** (~6.950 Mio. USD) im Infineon-Geschäftsjahr 2014
- Rund **34.000 Mitarbeiter weltweit***
- Starkes Technologieportfolio mit mehr als **22.800 Patenten und Patentanmeldungen** (Stand: September 2014)
- **32 F&E- und 20 Fertigungsstandorte**

*nicht testierte Zahlen

Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2015*
- Integration von International Rectifier
- Geschäftstätigkeit*
- Segmente, Produkte und Technologien*
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen*

*ohne International Rectifier

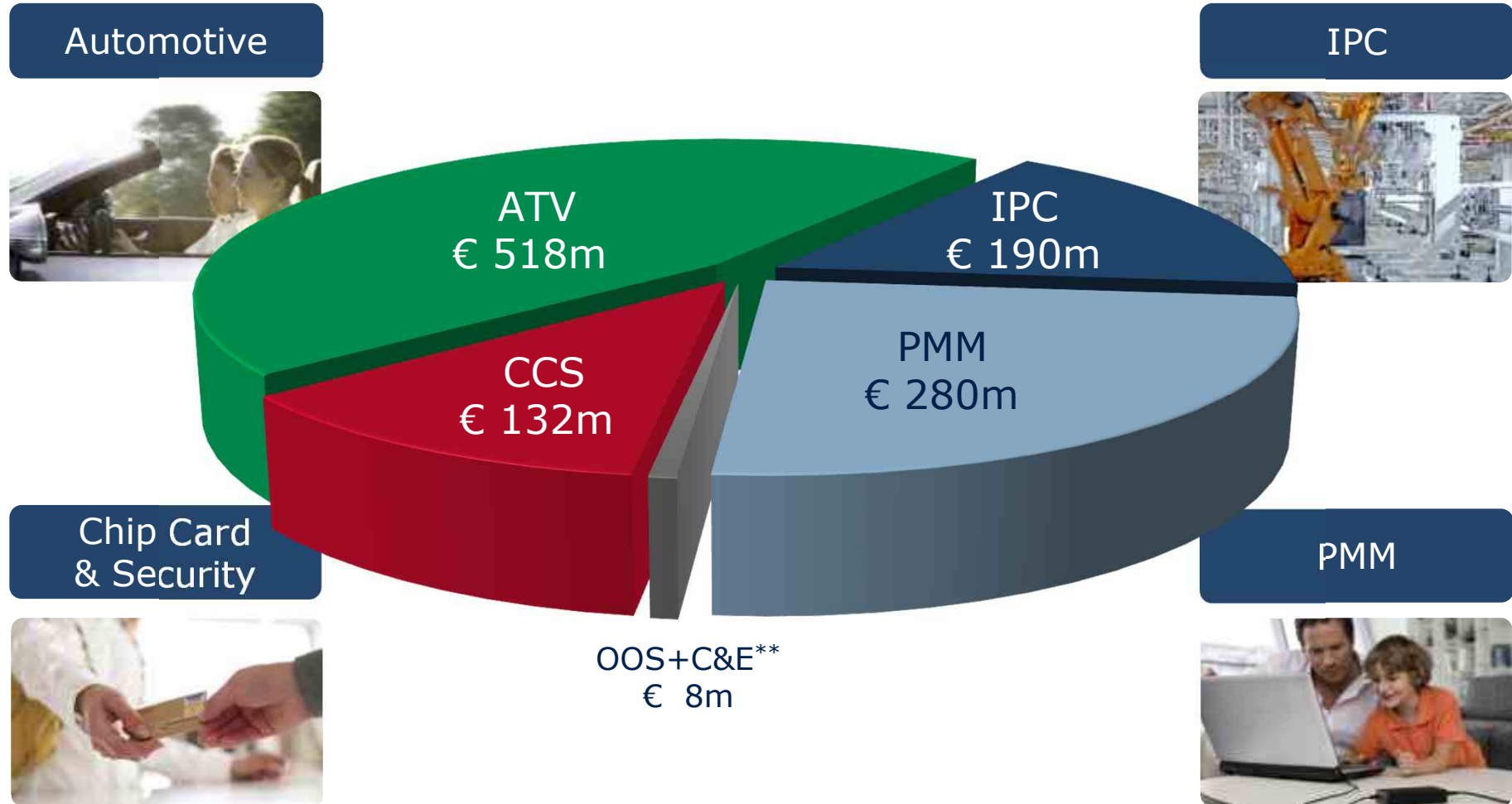
Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2015*
- Integration von International Rectifier
- Geschäftstätigkeit*
- Segmente, Produkte und Technologien*
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen*

*ohne International Rectifier

Umsatz nach Segmenten

Umsatz in Q1 GJ 2015: € 1.128 Millionen*

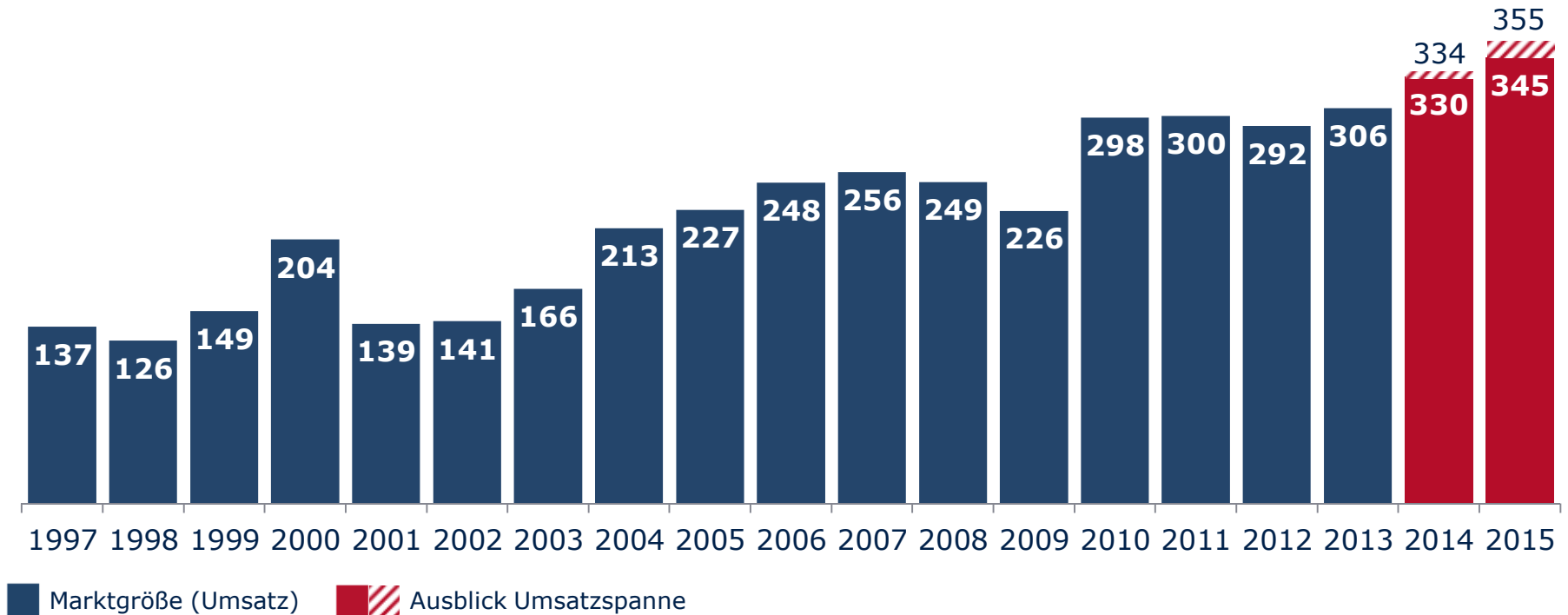


**Sonstige Geschäftsbereiche; Konzernfunktionen & Eliminierungen.

*ohne International Rectifier

Der Ausblick für den weltweiten Halbleitermarkt ist positiv

Globaler Halbleitermarkt in Milliarden US-Dollar

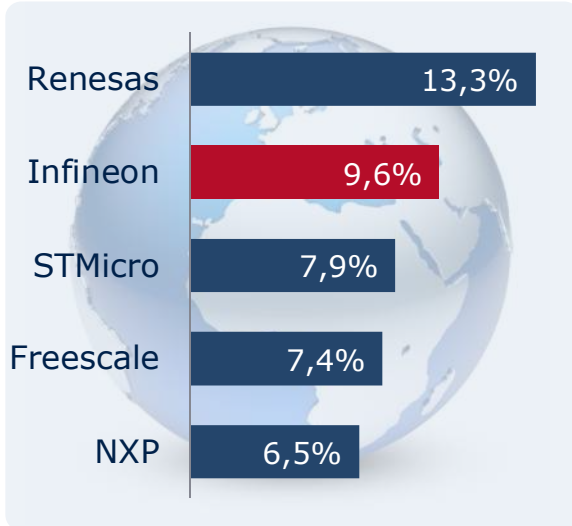


Quelle: WSTS für historische Daten; Ausblick: Ø von WSTS, IHS, Gartner, IC Insights; letzte Aktualisierung 26. Jan. 2015

Führende Positionen in allen wesentlichen Produktkategorien*

Automobilelektronik

Marktvolumen KJ* 2013:
\$25,1 Mrd.

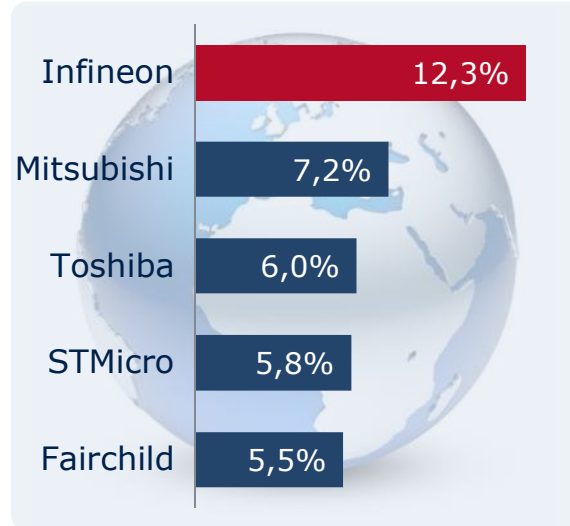


Halbleiter für
Automobilelektronik inkl.
Halbleitersensoren.

Quelle: Strategy Analytics,
April 2014.

Leistungshalbleiter

Marktvolumen KJ* 2013:
\$15,4 Mrd.

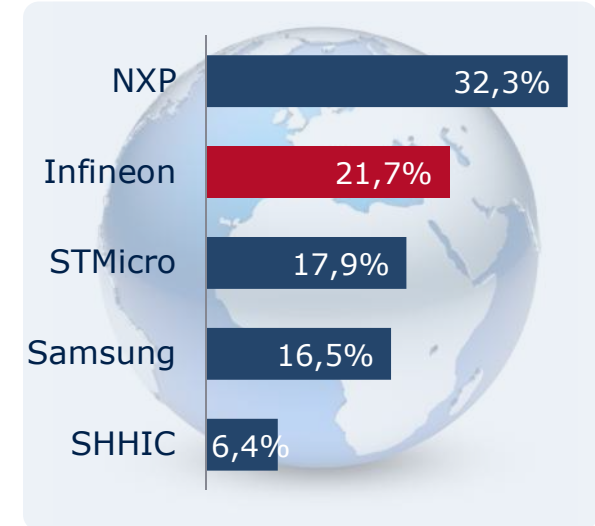


Diskrete Leistungshalbleiter und
-module.

Quelle: IHS, September 2014.

Chipkarten

Marktvolumen KJ* 2013:
\$2,48 Mrd.



Mikrocontroller-basierte
Chipkarten ICs.

Quelle: IHS, Juli 2014.

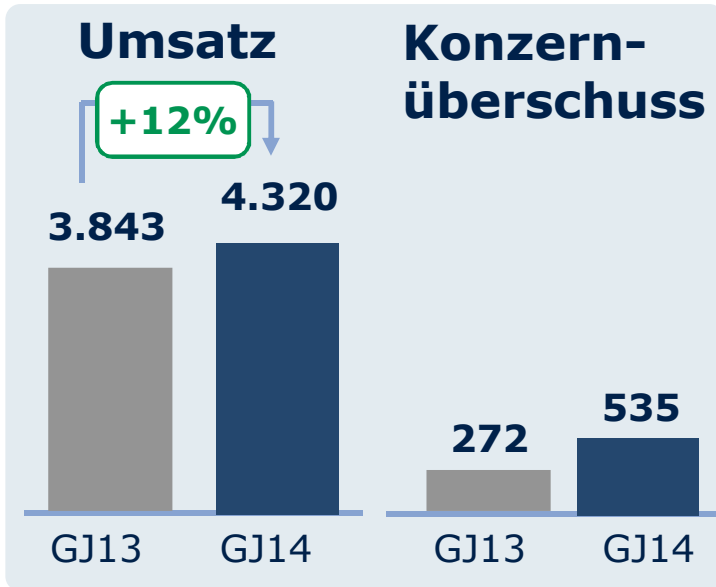
*Kalenderjahr, ohne International Rectifier

Infineon-Konzern

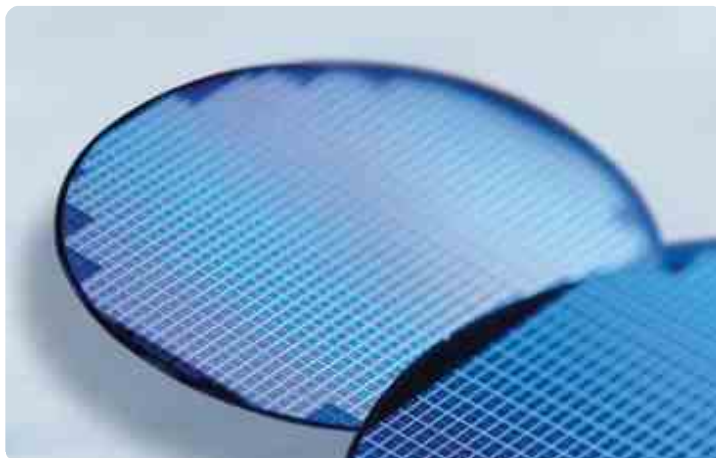
Ergebnisse GJ 2013* und GJ 2014*



*ohne International Rectifier

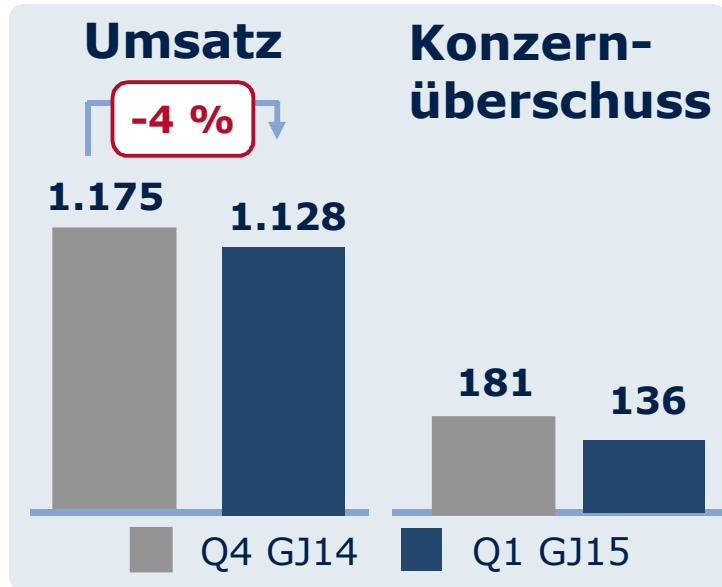


[Mio. €]	2013	2014	
Umsatz	3.843	4.320	↗
Segmentergebnis	377	620	↗
Segmenterg.-Marge	9,8%	14,4%	↗
Konzernüberschuss	272	535	↗
Free Cash Flow	235	317	↗
Investitionen	378	668	↗
Netto Cash Position	1.983	2.232	↗
Marktkapitalisierung**	~7.995	~9.240	↗



**Aktienkurs zum 30.9.2013: 7,395 Euro; Aktienkurs zum 30.9.2014: 8,193 Euro

*ohne International Rectifier



[Mio. €]	Q4 14	Q1 15
----------	-------	-------

Umsatz	1.175	1.128
--------	-------	-------

Segmentergebnis	188	169
-----------------	-----	-----

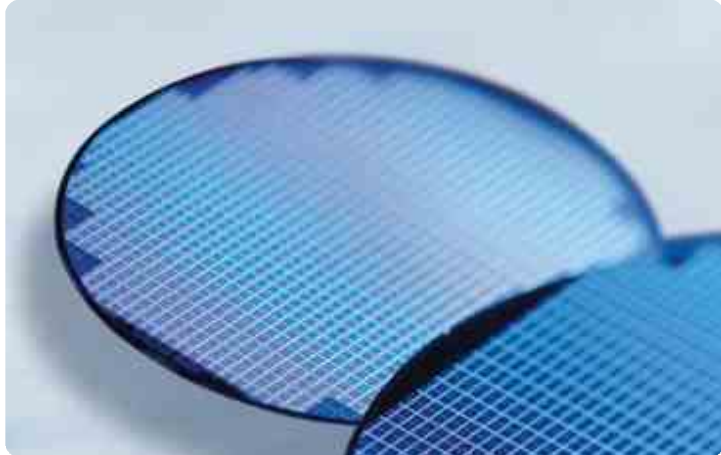
Segmenterg.-Marge	16,0%	15,0%
-------------------	-------	-------

Konzernüberschuss	181	136
-------------------	-----	-----

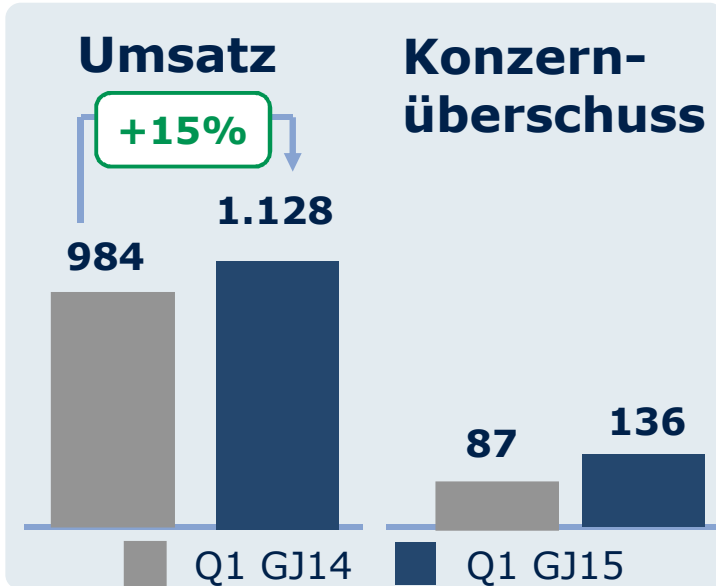
Free Cash Flow	158	-171
----------------	-----	------

Brutto Cash Position	2.418	2.107
----------------------	-------	-------

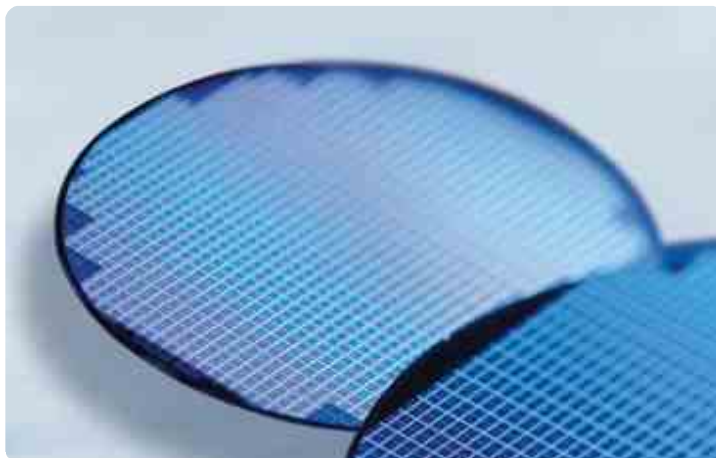
Netto Cash Position	2.232	1.917
---------------------	-------	-------



*ohne International Rectifier



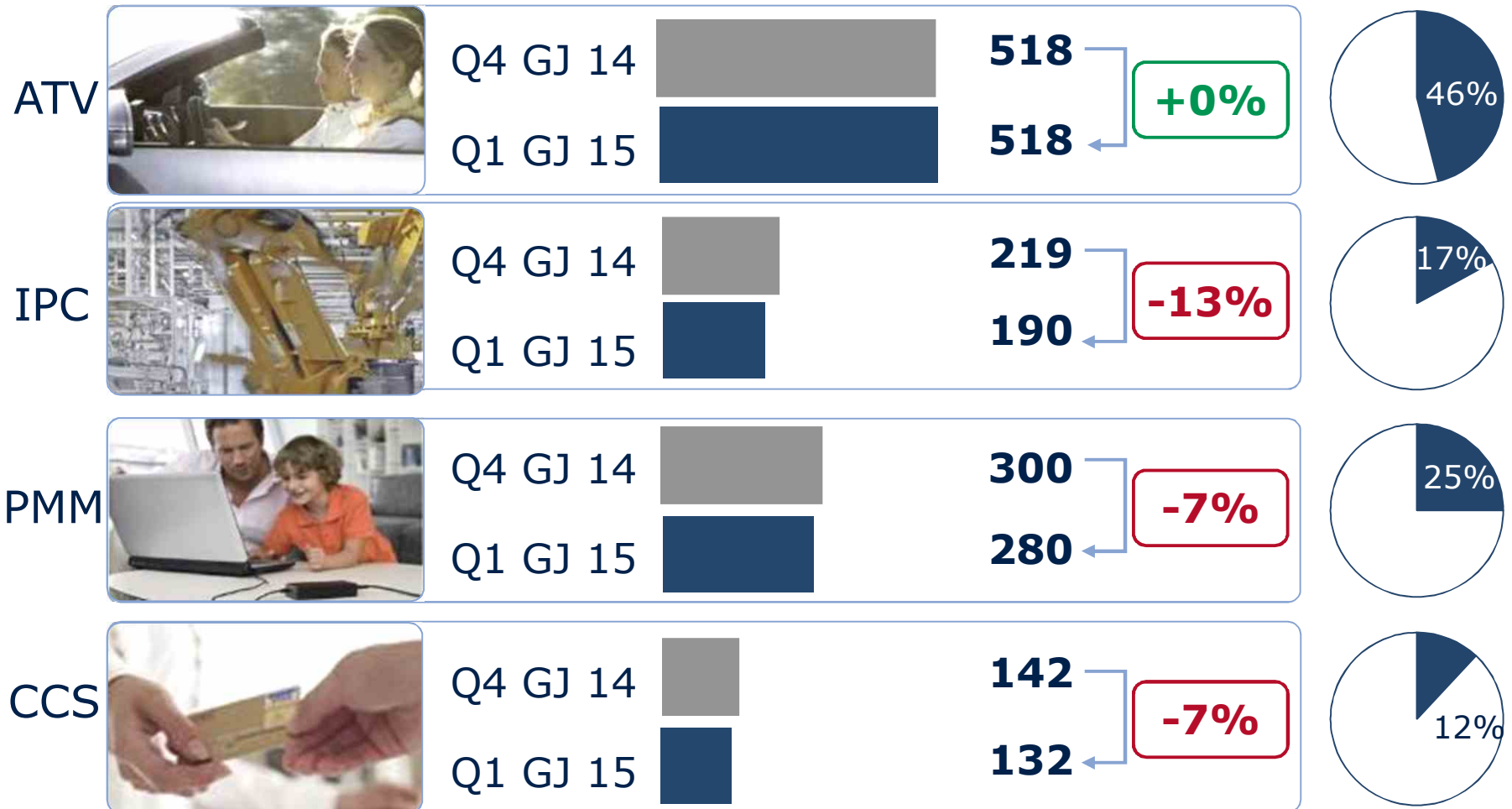
[Mio. €]	Q1 14	Q1 15	
Umsatz	984	1.128	
Segmentergebnis	116	169	
Segmenterg.-Marge	11,8%	15,0%	
Konzernüberschuss	87	136	
Free Cash Flow	30	-171	
Brutto Cash Position	2.279	2.107	
Netto Cash Position	2.048	1.917	



Umsatzerlöse nach Segmenten Q4 GJ 2014* und Q1 GJ 2015*

Umsatz** in Mio. €

Anteil am Gesamtumsatz







*ohne International Rectifier

**Im Gesamtumsatz (Q4 GJ14: 1.175 Mio. €; Q1 GJ15: 1.128 Mio. €) sind enthalten Sonstige Geschäftsbereiche (Q4 GJ14: 5 Mio. €, Q1 GJ15: 4 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q4 GJ14: -9 Mio. €, Q1 GJ15: 4 Mio. €).

Ergebnisse nach Segmenten Q4 GJ 2014* und Q1 GJ 2015*

Segmentergebnis** in Mio. €

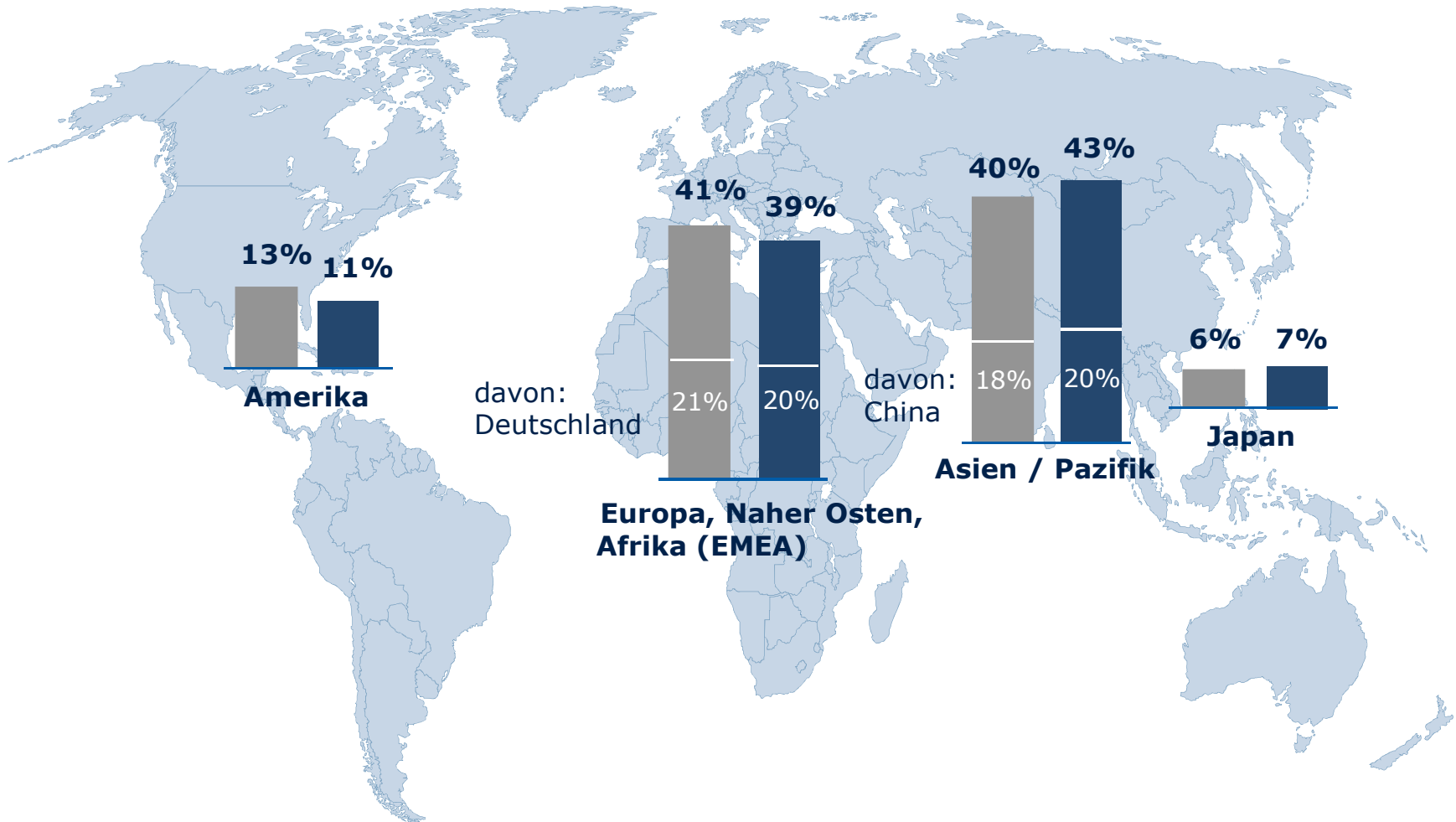
Marge

Segment	Q4 GJ 14	Q1 GJ 15	Marge
 ATV	69	72	13,3%
			13,9%
 IPC	44	28	20,1%
			14,7%
 PMM	60	48	20,0%
			17,1%
 CCS	20	18	14,1%
			13,6%

*ohne International Rectifier

**Im Gesamtsegmentergebnis (Q4 GJ14: 188 Mio. €; Q1 GJ15: 169 Mio. €) sind enthalten Sonstige Geschäftsbereiche (Q4 GJ14: 0 Mio. €, Q1 GJ15: 2 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q4 GJ14: -5 Mio. €, Q1 GJ15: 1 Mio. €).

Umsatz nach Regionen GJ 2013* und GJ 2014*



■ GJ 2013 ■ GJ 2014

*ohne International Rectifier

Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2015*
- **Integration von International Rectifier**
- Geschäftstätigkeit*
- Segmente, Produkte und Technologien*
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen*

*ohne International Rectifier

Breiteres Produktportfolio

- Erweiterung des Produktportfolios
- Breiteres und tieferes Verständnis für Anwendungen (Strategie „Vom Produkt zum System“)

Skaleneffekte

- Bessere Kostenstruktur dank vergrößerter Umsatzbasis
- Schnellerer Ramp-up der Fertigung auf 300mm-Dünnyafern

Größere Technologie-Expertise

- Breiteres GaN-Produkt- und IP-Portfolio
- Schnellere Roadmaps

Stärkere Präsenz in Regionen

- Bessere regionale Präsenz in den USA und im Raum Asien-Pazifik
- Ausbau des Marktzugangs über den Distributionskanal

International Rectifier – Ein Unternehmen von Infineon Technologies: Überblick



Kernkompetenzen/Wertbeitrag

- Breites Portfolio von analogen und digitalen Steuer-ICs und integrierten Produkten für Point-of Load (PoL), Gaming, High-end PCs und IKT
- Starkes Applikations-Know-how bei IKT, DC/DC und PoL
- Breites Spektrum an MOSFET/Gehäuse-Kombinationen
- Stake Präsenz bei Tier-2/-3 Kunden, insbesondere in den USA, Asien und Japan

Technologien/Produkte

■ Nieder- und Mittelvolt-MOSFETs

- Industrie
- Stromversorgung
- Consumer und Computing
- High Reliability (Höchste Zuverlässigkeit)

■ Stromversorgung mit digitaler Steuerung

- Steuer-ICs
- High Performance Computing
- Server

■ Hochvolt-IGBTs und ICs

- Haushaltsgeräte
- Industrie
- Motorsteuerung
- Leistungsmodule für Haushaltsgeräte und Industrie (IPM)

■ IGBTs für Automobilanwendungen

■ Galliumnitrid (GaN)-Technologie

Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2015*
- Integration von International Rectifier
- **Geschäftstätigkeit***
- Segmente, Produkte und Technologien*
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen*

*ohne International Rectifier

Wir konzentrieren uns auf unsere Zielmärkte

Fokusthemen

- Energieeffizienz
- Mobilität
- Sicherheit



Kernkompetenzen

- Analog- und Mixed-Signal Schaltungen
- Leistungshalbleiter
- Embedded Control
- Fertigungskompetenz

Unsere Zielmärkte

- Automobilelektronik
- Industrieelektronik
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Sicherheit



Fokussierung auf drei zentrale Bedürfnisse der modernen Gesellschaft

Energieeffizienz



Mobilität



Sicherheit



Automotive

Industrial Power Control

Power Management & Multimarket

Chip Card & Security

Energieeffizienz



Wichtige Trends

- Dem dramatisch steigenden weltweiten Energiebedarf stehen schwindende Ressourcen fossiler Energieträger gegenüber
- Strenge CO₂-Richtlinien sollen das Erreichen von Klimazielen sichern
- Erneuerbare Energien werden vermehrt als nachhaltige Ressourcen genutzt
- Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Kraftfahrzeugen

Unser Beitrag

- Unsere innovativen Halbleiterlösungen spielen eine wichtige Rolle bei der Minimierung von Leistungsverlusten und steigern die Effizienz der gesamten Energie-Versorgungskette – von der Erzeugung über die Verteilung bis zur Nutzung.
- Unsere Produkte bilden die Grundlage für die intelligente und optimale Nutzung von Energieressourcen in der Industrie, in Privathaushalten und in Fahrzeugen.



Wichtige Trends

- Strenge CO₂-Richtlinien und steigender Ölpreis
- Neue Sicherheitsvorschriften für die Unfallprävention
- Wachsender Markt für preiswerte Fahrzeuge in Schwellenländern
- Urbanisierung, Globalisierung und demografische Veränderungen
- Große Investitionen in öffentlichen Nah- und Fernverkehr

Unser Beitrag

- Unsere führenden Halbleiterlösungen ermöglichen eine nachhaltige Mobilität, indem sie dazu beitragen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Anschaffungskosten zu senken.
- Als Innovationsmotor und Anbieter von Schlüsselkomponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge wird Infineon auch weiter den Wandel in Richtung Elektromobilität mitgestalten.
- Innovative Lösungen für Antriebe und elektronische Tickets im öffentlichen Personenverkehr.



Wichtige Trends

- Sichere Kommunikation überall – mit Mobiltelefon und mobilem Internet
- Einführung von elektronischen Ausweisen und Produktkennzeichen
- Zahlungssysteme mit kontaktlosen Karten und elektronische Tickets
- Zunehmende Vernetzung des Autos erfordert sicheres Datenmanagement
- Einführung von Smart Grids erfordert erhöhte Datensicherheit

Unser Beitrag

- Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für alle Systemanforderungen ermöglichen die Implementierung transparenter Sicherheitsfunktionen in Standardsystemen.
- Sicherheitsanwendungen in der Industrie und im Automobilsektor profitieren von unserer globalen Kompetenz im Bereich Smartcards.
- Unsere Produkte verbinden Hardware-Sicherheit mit Verschlüsselung und bilden damit die Grundlage für Vertraulichkeit und Sicherheit sowie erweiterte Kommunikationsfunktionen, ohne die persönliche Freiheit einzuschränken.

Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2015*
- Integration von International Rectifier
- Geschäftstätigkeit*
- **Segmente, Produkte und Technologien***
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen*

*ohne International Rectifier

Enge Kundenbeziehungen basieren auf System-Know-how und Applikationsverständnis*



*ohne International Rectifier

ATV



IPC



PMM



CCS



EMS-Partner



Distributionspartner



Marktorientierte Geschäftsstruktur*

*ohne International Rectifier

Segmente

Anwendungsfelder



Produktspektrum*

*ohne International Rectifier



Automotive (ATV)

- Mikrocontroller (8-Bit, 16-Bit, 32-Bit) für Automobil- und Industrieanwendungen
- Software-Entwicklungsplattform DAVE™
- Diskrete Leistungshalbleiter
- IGBT-Module
- Spannungsregler
- Leistungs-ICs
- Busschnittstellen-Bausteine (CAN, LIN, FlexRay)
- Druck- und Magnetfeldsensoren
- Drahtlos-Sende- und -Empfangs-ICs (HF, Radar)



Industrial Power Control (IPC)

- IGBT-Modul-Lösungen inkl. IGBT-Stacks
- IGBT-Module für niedrige, mittlere und hohe Leistungsklassen
- Diskrete IGBTs
- "Bare Die"-Geschäft
- Treiber-ICs



Power Management & Multimarket (PMM)

- Diskrete Niedervolt- und Hochvolt-Leistungshalbleiter
- Treiber-ICs
- Ansteuer-ICs
- Hochfrequenz-Leistungstransistoren
- Kleinsignal-komponenten
- Hochfrequenz-Antennenmodule (System-in-Package)
- Antennen-Tuning-ICs
- Chips für Silizium-Mikrofone
- Kundenspezifische Chips (ASICs)



Chip Card & Security (CCS)

- Kontaktbasierte Sicherheitscontroller
- Kontaktlose Sicherheitscontroller
- Sicherheitscontroller mit kontaktloser sowie kontaktbasierter Schnittstelle (Dual-Interface)

Eine neue Ära: Steigende Nachfrage im Bereich der Leistungshalbleiter

'90 – '10

'10 – '30

Veränderungen



Bildquelle: BMW-Group

- Die Elektrifizierung von Fahrzeugen mit herkömmlichen Motoren sowie der Trend zur Elektromobilität sorgen für höheren Bedarf an Leistungshalbleitern.



- Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien erfordert deutlich mehr Leistungshalbleiter pro MW erzeugtem Strom.



Bildquelle: Facebook

- Eine effizientere Stromwandlung sorgt für einen niedrigeren CO₂-Ausstoß und verringert die Gesamtkosten über die Laufzeit.



- Aufgrund des steigenden Lebensstandards in den BRIC-Staaten erhöht sich die Nachfrage nach Anwendungen mit Leistungshalbleitern.



Kernkompetenzen/Wertbeitrag

- **Nachhaltiges Engagement:** über **40 Jahre System- und Anwendungs-Know-how**
- **Anbieter kompletter Automotive-Systeme**
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** branchenweit **führend bei Know-how** und Produktportfolio
- **Funktionale (ISO26262) und Daten-Sicherheit** im Auto
- **Weltweite** Entwicklungs-, Fertigungs- und Support-Standorte für Automotive-Halbleiter
- **Next Level of Zero Defect:** umfangreichstes Qualitätsprogramm in der Halbleiterbranche

Produktpalette

- **Sensorik:** Druck-, Magnetsensoren, Wireless Control-ICs, Radar
- **Mikrocontroller:** 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit
- **Leistungshalbleiter:** MOSFETs, IGBTs, intelligente Leistungs-ICs: Spannungsregler, Brücken, Treiber-ICs, CAN/LIN/FlexRay™-Transceiver**, DC/DC-Wandler, SoC, Embedded Power-ICs
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** HybridPACK™-Module, Automotive Easy-Module, Gate-Treiber-ICs, MOSFETs, IGBTs

Marktposition*

- **Nr. 2** bei Automotive-Halbleitern weltweit
- **Nr. 1** Europa
- **Nr. 1** Korea
- **Nr. 2** Nordamerika
- **Nr. 3** Japan

- **Nr. 1 bei Automobil-Leistungshalbleitern** (21,3%)

*Quelle: Strategy Analytics (April 2014), ohne International Rectifier

**FlexRay ist eine Marke der FlexRay Consortium GbR und wird unter Lizenz verwendet

Fokus auf Zukunftstechnologien: Umweltfreundliche Autos

Markttrends

- Knapper werdende Energieressourcen
- Urbanisierung
- Strengere Vorgaben zum CO₂-Ausstoß
- Wachsendes Umweltbewusstsein

Chancen für Infineon

- Infineon-Bausteine ermöglichen den Autoherstellern, die ambitionierten Ziele für die Reduzierung von CO₂ zu erreichen, z.B. 95g CO₂/km bis 2021 in der EU.
- Wir bieten Produkte für den Antriebsstrang von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HybridPACK™).
- Halbleiter machen Elektroautos überhaupt erst möglich (elektrische Antriebe/ Steuerungen, Batteriemanagement, integrierte Batterieladefunktionen und Fahrzeugnetzkommunikation).



BMW und Infineon: gemeinsam die Zukunft der Elektromobilität gestalten



Leistungselektronik-Modul



- 75 Halbleiter sorgen für einen hocheffizienten Elektroantrieb im BMW i3, z.B. Mikrocontroller AUO Future, IGBT Leistungsmodul HybridPACK™ 2, Treiber-Bausteine EiceDRIVER™, CoolMOS™ Hochvolt-MOSFETs.
- Weitere Komponenten: Steuerung von Airbags, LED-Lichtmodul, Lenkungsverriegelung, Scheibenwischer und Gurtaufroller.



Kernkompetenzen/Wertbeitrag

- Hochwertige Produkte und Services
- Führendes Technologie- und IP-Portfolio
- System-Know-how und umfassendes Anwendungswissen
- Starke weltweite Präsenz mit Standorten für lokale Vertriebs- und Anwendungsunterstützung
- Dedizierte Kundenbetreuungsteams und Distributoren

Produktpalette

- **IGBT Module:** Standard IGBT Module, Power Integrated Module (PIM)
- **IPM Module:** Intelligent Power Module (IPM)
- **Diskrete IGBTs**
- **Treiber ICs:** Treiberbausteine zur Ansteuerung von IGBT-Modulen und diskreten Komponenten
- **Power Stacks:** Mit Schutzfunktionen und Sensorik aufgebaute Leistungsteil aus Halbleitermodul, Kühlkörper, Treiberelektronik

Marktposition*

- Nr.1 in Diskreten IGBTs mit 24,7% Marktanteil
- Nr.2 in IGBT-Modulen mit 20,5% Marktanteil
- Nr.2 in IGBT-Halbleiterprodukten weltweit (Module und Diskrete)
 - Nr.1 in Europa
 - Nr.1 in China

Leistungskomponenten für die Antriebssteuerung bei Zugsystemen

Hochgeschwindigkeitszüge



U-Bahnen



Infineon-Komponenten

- Leistung: 5 bis 10MW pro Zug
- 80 bis 120 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:
~ €100.000 pro Zug



- Leistung: 0,5 bis 1MW pro Zug
- 25 bis 50 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:
~€ 10.000 pro Zug

Leistungskomponenten für Windkraftanlagen und HGÜ-Verbindungen für Offshore-Parks



Onshore/Offshore-Windkraftanlagen



HGÜ-Verbindungen für Offshore-Parks



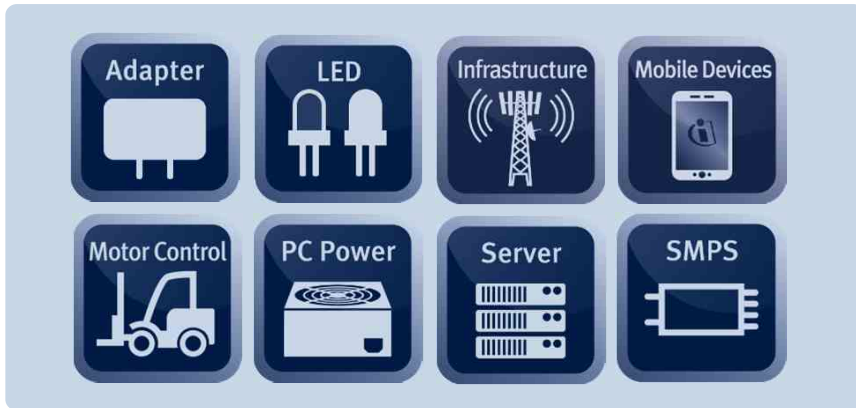
Infineon-Komponenten

- Leistung: 1MW bis 6MW pro Turbine
- 12 bis 48 IGBT-Module **oder** 6 bis 12 Power Stacks pro Turbine
- Halbleiteranteil: ~ € 5.000 pro MW



- Leistung ist abhängig von der Anzahl angeschlossener Offshore-Parks
- 4.000 bis 16.000 Module pro Verbindung
- Halbleiteranteil: ~ € 5.300 pro MW

HGÜ: Hochspannungsgleichstromübertragung



Kernkompetenzen/Wertbeitrag

- Technologieführerschaft in Leistungselektronik und Hochfrequenz
 - Beste Energieeffizienz
 - Höchste Leistungsdichte zur Einsparung von Fläche und Gewicht
 - Mobile, zuverlässige Datenübertragung
- Führende Innovationen zur einfachen Nutzung
 - Anwendungsorientierte Ausrichtung
 - Hohe Kompetenz in Integration von digitaler, diskreter Leistungselektronik und Gehäuse
- Systemverständnis für noch effizienteres Leistungsmanagement

Produktpalette

- Digitale Leistungs-ICs, Treiber und Diskrete Leistungshalbleiter für Spannungsregler
- LED-Treiber
- HF-Dioden und -Transistoren, HF-Leistungsverstärker
- Chips für Silizium-Mikrofone, TVS-Dioden
- ASIC-Lösungen u.a. für Authentifizierung- und Batteriemangementanwendungen

Marktposition*

- **Nr. 1 in Diskreten Standard MOSFETs 14%** Marktanteil (IHS: The World Market for Power Semiconductor Discretes & Modules – Sep. 2014)
- **Nr. 1 bei Leistungshalbleitern mit 12%** Marktanteil (IHS: The World Market for Power Semiconductor Discretes & Modules – Sep. 2014)
- **Nr. 2 bei Chips für Silizium-MEMS-Mikrofonen mit 30%** Marktanteil (IHS: MEMS Microphones Report– April 2014)
- **Nr. 3 bei HF-Leistungshalbleitern mit 14%** Marktanteil (ABI Research: RF Power Amplifiers; April 2014)

*ohne International Rectifier



Leistungskomponenten für Server & HF Bauteile Mobilfunk-Kommunikation und Infrastruktur



Power Management

Computing



Lighting



Charger



Mobile Communications

Mobile devices



Cellular infrastructure



Portfolio: MOSFETs, Power ICs, RF switches, LNAs, Si-Mics, TVS diodes, RF power

- Effizienzleistungen von 95% und höher
- Technologieführerschaft bei Leistungshalbleitern basierend auf Silizium und Siliziumkarbid
- Höchste Leistungsdichte für bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Herausragende Systemlösungen mit MOSFETs, ICs und Treiber-Bauelementen

- Silicon Microphone Sensor Element mit herausragender akustischer und elektrischer Leistung
- Exzellente Leistung bei ESD Schutz
- Best-in Class Kleinsignalverstärker

- Abdeckung aller Standard-Frequenzbänder in 2G,3G,4G (450 MHz bis 2.7 GHz)
- Führende Leistungseffizienz für LTE
- Großes Produktportfolio für ein Leistungsspektrum von 4W bis 700W
- Exzellente thermische Eigenschaften

Soziale Netzwerke und Cloud-Computing verstärken Nachfrage nach hocheffizienten Netzteilen



Digital Power Management (DPM) im Servermarkt auf dem Vormarsch

amazon.com.

Google



Picasa

Microsoft

YouTube

CoolMOS™

OptiMOS™

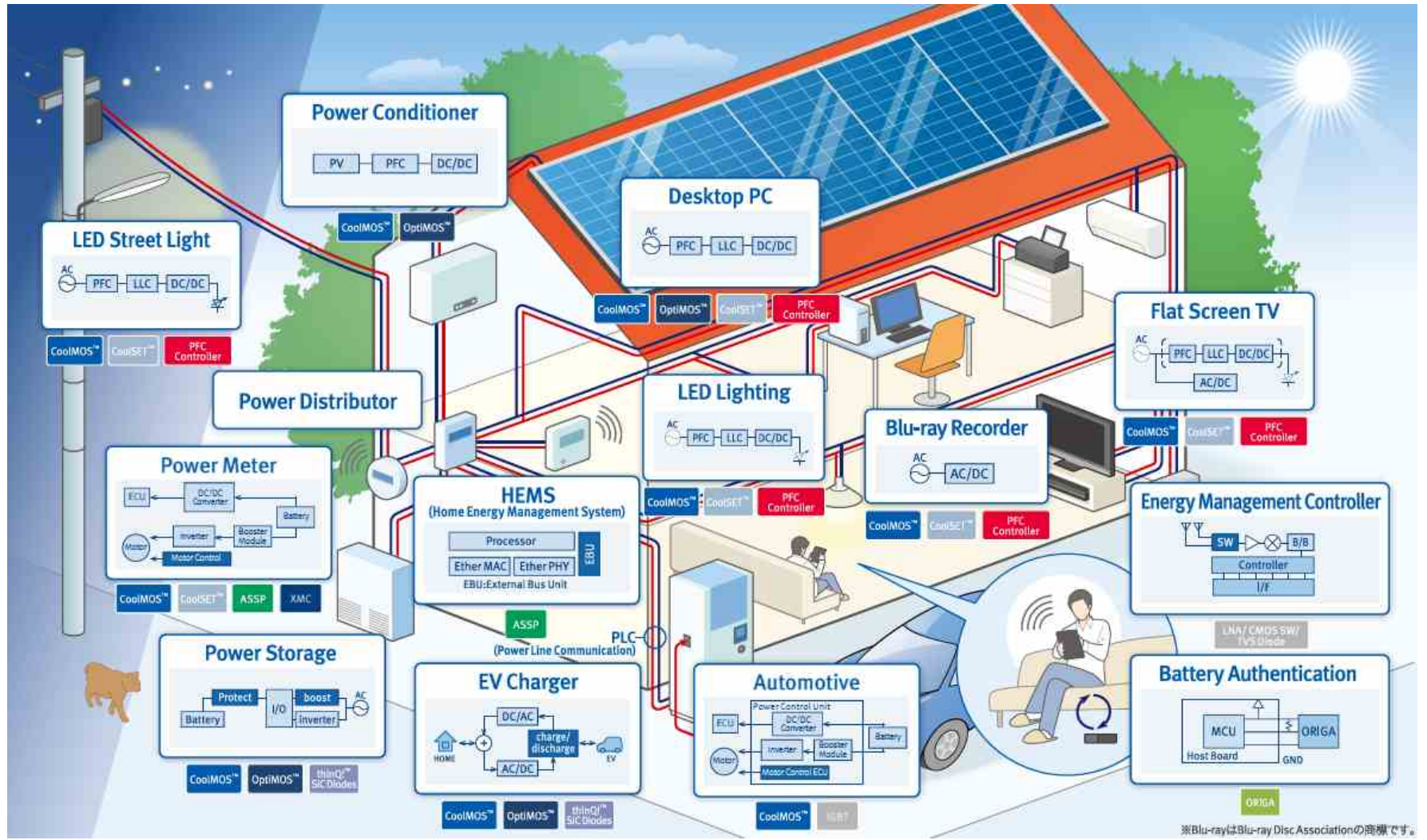
Controller & Treiber-IC



- Weltweit geht pro Woche ein neues Rechenzentrum mit bis zu 100 MW Leistungsaufnahme in Betrieb
- Die Effizienz von Netzteilen (AC/DC, DC/DC) ist von großer Bedeutung
- DPM ist die optimale Lösung für flexible Lastanforderungen
- Veränderte Wertschöpfung: Maßgeschneiderte Lösungen von ODMs ersetzen Standard-Server

- DPM erleichtert Kombination mit anderen Produkten
- Neuester Design-Win: DPM-Controller mit Treiber-ICs und MOSFETs bei ODM in Taiwan

Leistungshalbleiter: Lösungen für effiziente Energienutzung



※Blu-rayはBlu-ray Disc Associationの登録です。



Kernkompetenzen/Wertbeiträge

- Tailored Security: maßgeschneiderte Sicherheit mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Contactless Excellence: Schwerpunkt auf Interoperabilität und Dual Interface
- Embedded Control: ausgewogenes Verhältnis von Rechenleistung, Stromverbrauch, Sicherheitsniveau und Kosten

Produktpalette

- Innovative Lösungen von einfachen Sicherheits-RFID- und Speicheranwendungen bis hin zu High-End-Sicherheitscontrollern (z.B. die preisgekrönte SLE 78-Familie)
- Kontaktlose und kontaktbasierte Sicherheitsprodukte für Kommunikation, Zahlungsverkehr, behördliche Ausweise, öffentlichen Personenverkehr, Zugangskontrolle, Objektidentifikation, Unterhaltung und Plattformensicherheit
- Umfassendes Packaging- und Serviceangebot

Marktpositionen

- Nr. 2 auf dem Markt für Microcontroller Smart Card IC mit 21,7%¹ Marktanteil in KJ* 2013 nach Umsatz
- Nr. 2 in Payment mit 28%³ Marktanteil in KJ* 2013
- Nr. 2 bei der Government Identification mit 32%⁴ Marktanteil in KJ* 2013
- Nr. 1 bei TPM; Führungsposition bei Authentication ICs und Mobile Security ICs (Sicherheits-Elemente bei Baugruppen und SIM cards)

Boosted NFC Secure Element für Smart Watch und Armband von Watchdata

- NFC-Sicherheitschip (Boosted NFC Secure Element) wird in tragbaren Geräten wie der Smartwatch „Sharkey“ verwendet
- „Sharkey“-Smart-Watch und Armband sind nicht mehr nur private Management-Systeme beim Sport; mittlerweile fungieren sie auch als sichere Geldkarten und bieten Flexibilität für Fahrkartenanwendungen im Transportwesen
- Boosted NFC bietet Sicherheit auf höchstem Level, ist „Common Criteria EAL 6+“-zertifiziert und von der EMVCo freigegeben



„Das Sicherheitselement von Infineon lässt sich nahtlos in unser intelligentes tragbares Gerät integrieren und bietet gleichzeitig **ausgeklügelte Sicherheitsfunktionen** und **exzellente kontaktlose Leistung**“

Jack Pan, Vice President, Watchdata Technologies

Infineon wurde für seine führenden Innovationen in China ausgezeichnet

Infineon gewinnt den Blue Shield Cup Security Anti-counterfeiting Technology

- Im Geschäfts-Quartal 4 wurde Infineon für seine **SLE78 Integrity Guard and Flexible Mask Solution** mit zwei Preisen des Blue Shield Cup Security Anti-counterfeiting Technology in China ausgezeichnet:
 - *Innovation Award*
 - *Foreign-investment Enterprise*
- Infineons SLE78 security microcontroller werden nun offiziell vom **chinesischen Außenministerium** in der neusten Generation elektronischer Ausweise für Diplomaten und andere Regierungsvertreter eingesetzt



Halbleitertechnologie-Portfolio*

Das Technologieportfolio von Infineon erfüllt die Anforderungen von Anwendungen für Logik- und Leistungselektronik-Bauelementen

Power/Analog



inkl. Green Robust

Analog Bipolar: DOPL, Ax, BIPEP, B4C
Analog BICMOS: B6CA, B6CA-CT, B7CA, SPT170
 500 - 350nm HV-CMOS-SOI
Smart Power: 1200-130nm BIP/CMOS/DMOS
 SPTx (Automotive, EDP) (BCD)
Smart: CMOS/DMOS, SMARTx, MSMARTx,
 SSMARTx Opto-TRIAC, SPS

DMOS: Low Voltage Trench
 MOSFET (OptiMOS™)
HV-DMOS: Superjunction MOSFET
 (CoolMOS™)
IGBT: Trench IGBT 600-6500V, rev.
 cond., fast recov. diodes
SiC: Diode, JFET

alle Produkte sind für Automotive- und Industrieanwendungen geeignet

MEMS/Sensoren



Analog ICs: B6CA, B7CA
 Coreless Transformer
Magnet: BxCAS, C9FLRN_GMR
Opto: OP-DI, OP-TR, OP-C9N, μ -modules

Pressure: BxCSP, TIREP \times
Silicon-Microphones: DSOUND

CMOS



Digital CMOS: 800nm – 65nm Technology Nodes (Platform <180nm incl. RF, AMS)
Analog/Mixed Signal: 500nm – 180nm Technology Nodes (CxNA)
eNVM: EEPROM: IMEMR, C9FL, OTP: C5OP (Automotive)
eFlash/EEPROM: 250nm – 65nm CxFL (Chip Card), CxFLA, CxFLN (Automotive)
HV-CMOS: 130nm, C11HV

RF/Bipolar



RF BICMOS: 25GHz – 100GHz: B6HFC, B9COPT, B10C
Bipolar IC: 2GHz...200GHz RF-Bipolar: BxHF
HiPAC: Al/Cu Integrated Passives
 P7Mxx, P7Dxx, P8Mx

SiGe: B7HFM, B7HF_SLC, B7HF200
RF Switches: C7NP, C11NP

Bipolar/Discrete Bausteine/MMIC:
RF-Transistoren NF-TR; BxHF(D/M),
Leistungsverst.: LDMOS, LDxM, LDxIC, LD9AB
Dioden: NF-DI, Tuner: DxT, Schottky: DxS

SiGe: B7HFD/M, B7HF_SD
RFMOS: HFM
PIN: DxP

Gehäusetechnologie-Portfolio*

IC

Wafer Level Packages, Bare Die

Surface Mount Technology (SMD)

- Wafer Level**
w/o redistribution
- WLP (fan-in)
- w/redistribution
- WLB (fan-in)
 - eWLB (fan-out)
 - Blade

Bare Die

- Wirebond
- Flip chip

Laminate based Packages

- SMD**
- OCCN ^{1,2)}
 - BGA
 - LBGA
 - xFBGA, xFSGA

Leadframe based Packages

- Through Hole**
- DIP ²⁾
- SMD**
- PLCC ²⁾
 - TSSOP
 - TQFP
 - LQFP
 - MQFP
- Leadless**
- VQFN
 - WQFN
 - O-LQFN ¹⁾
 - XSON
 - USON

Chip Card

- Mold on LF Mold**
- P-MCCx
 - P-Mx.x
- Chip on Flex**
- FTM
- UV Globe top**
- T-Mx.x
- PRELAM**
- PPxx
- Flip Chip**
- S-MFCx.x
 - S-COMx.x
- Wafer**
- Bumped
 - Diced

Discretes

- SMD leaded**
- SOT
 - SOD
 - TSOP
 - TSSOP
- Flat lead**
- TSFP
 - SC
- Leadless**
- TSLP
 - TSSLP
 - TSNP
- Wafer level**
- WLP
 - WLL

Sensors

- Through Hole**
- PSSO
- SMD Leaded**
- DSOSP
- Open cavity**
- DSOF

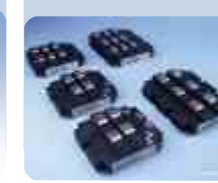
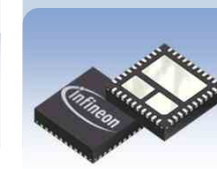
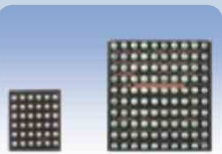
Power

Power

- Through Hole**
- TO, DIP
- SMD**
- TO
 - DSO
 - SSOP
- Leadless**
- ThinPAK
 - TDSON
 - TSDSON
 - CanPAK™
 - TISON
 - WISON
 - IQFN
 - HSOF

High Power

- Power Modules**
- Easy
 - 34mm
 - 62mm
 - Econo
 - Econo-PACK™+
 - Prime-PACK™
 - IHM
 - IHV
 - Hybrid-PACK™



1) Nur für Spezialanwendungen 2) Auslauf

Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2015*
- Integration von International Rectifier
- Geschäftstätigkeit*
- Segmente, Produkte und Technologien*
- **Allgemeine Informationen zum Unternehmen***

*ohne International Rectifier

F&E-Standorte in Europa*

*ohne International Rectifier

Warstein

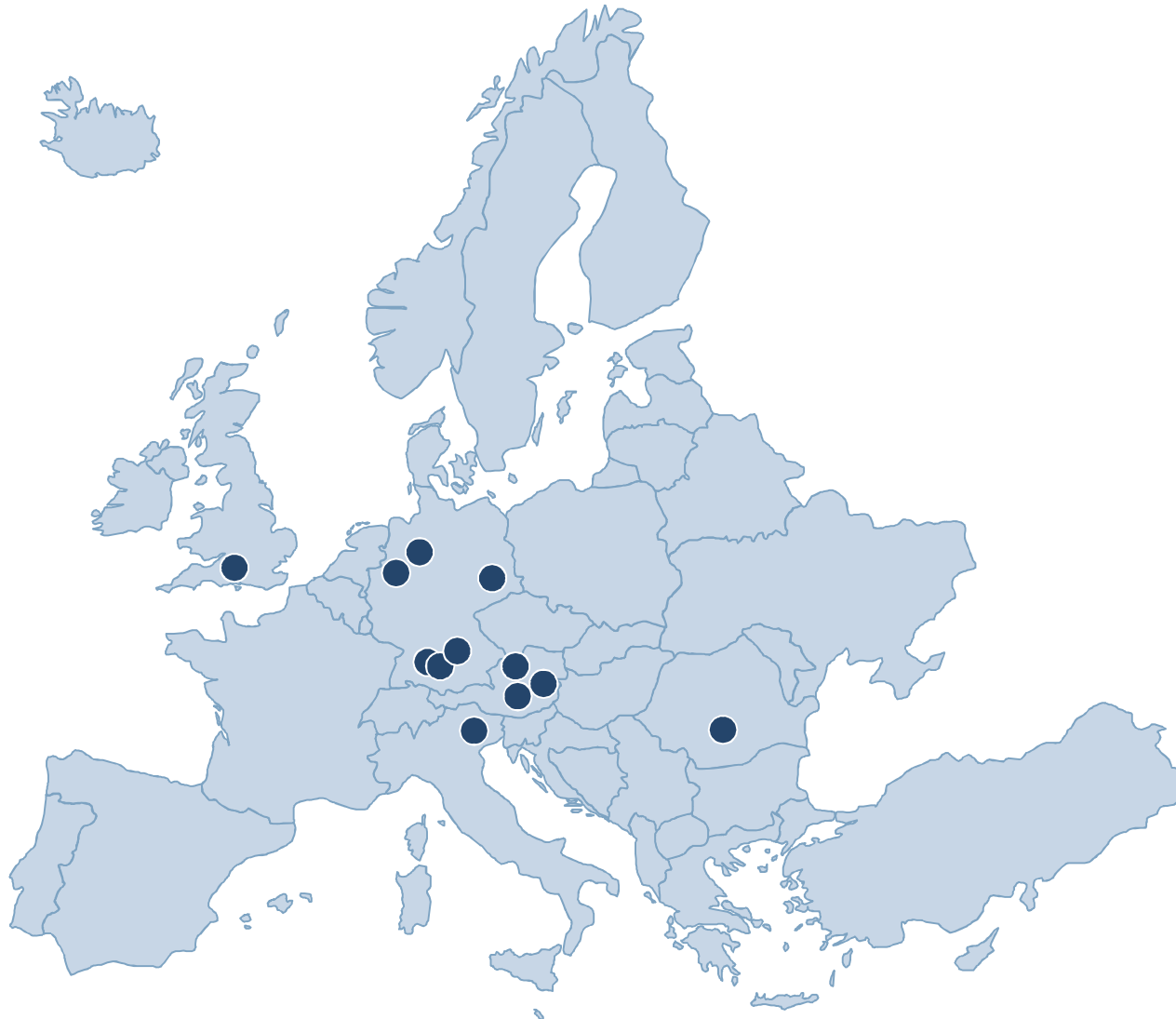
Duisburg

Bristol

Augsburg

München,
Neubiberg

Padua



Regensburg

Dresden

Linz

Graz

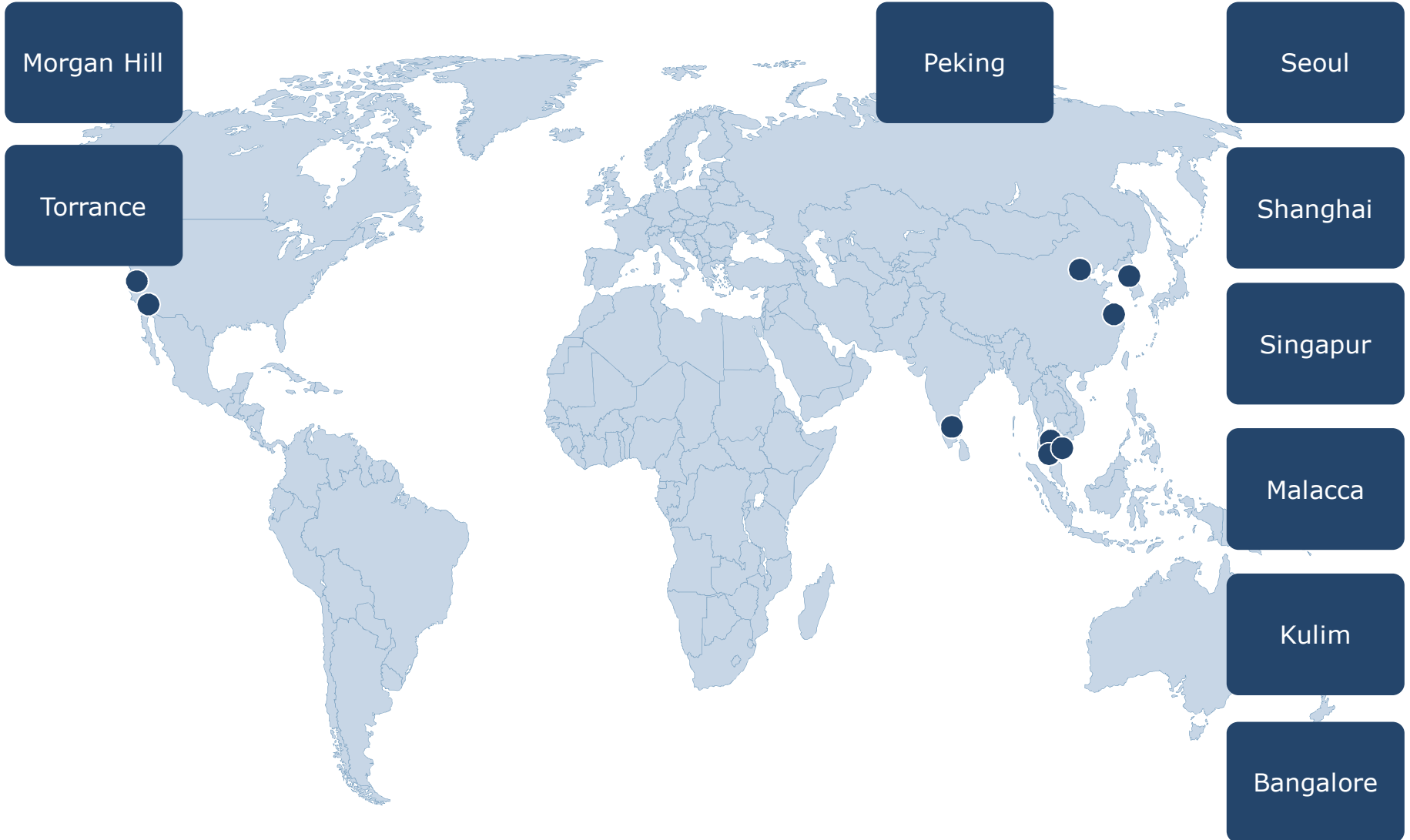
Bukarest

Villach

Weltweite F&E-Standorte (ohne Europa)*



*ohne International Rectifier



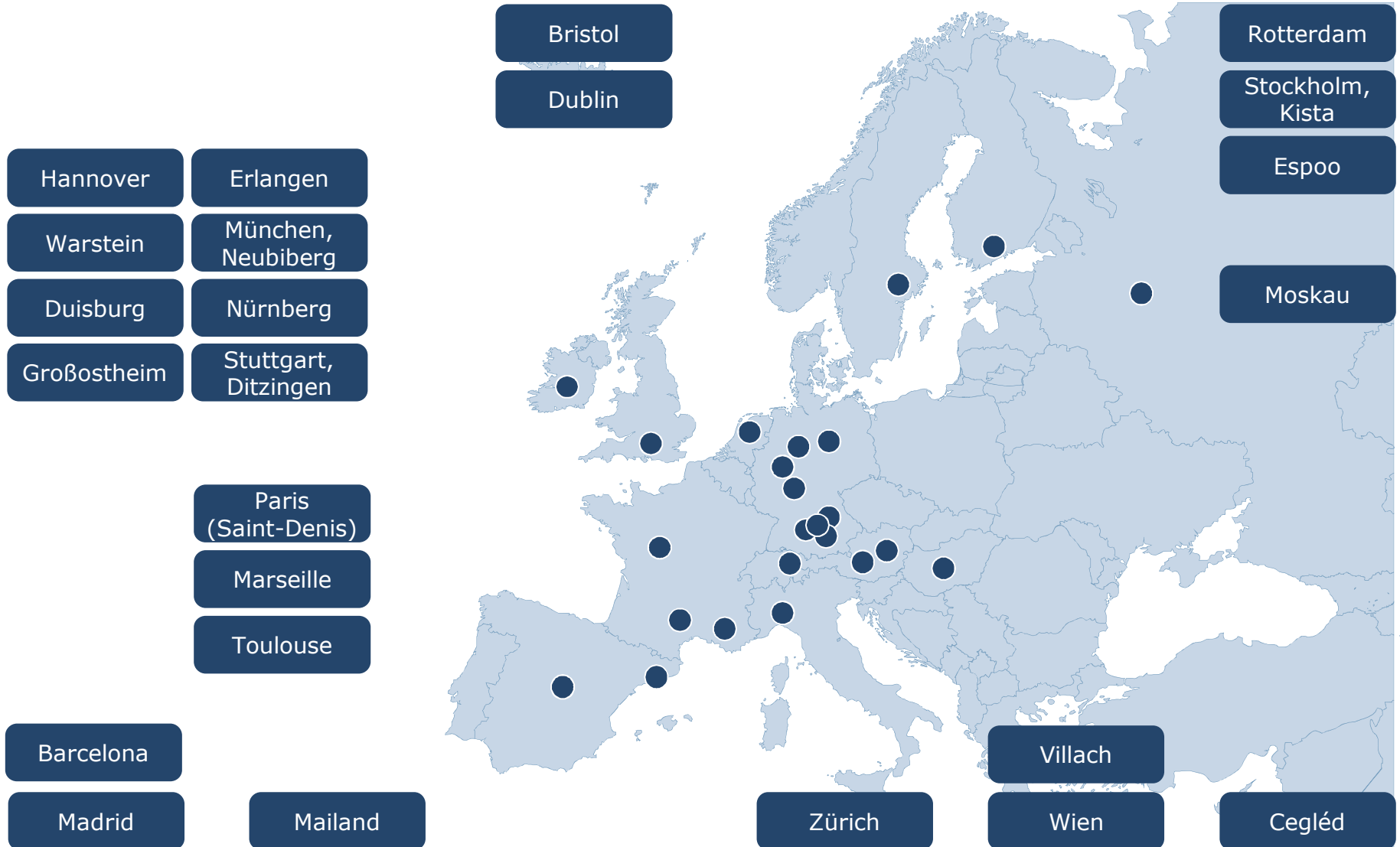
Weltweite Fertigungsstätten Frontend- und Backend-Fertigung*

*ohne International Rectifier



Vertriebsbüros in Europa*

*ohne International Rectifier



Vertriebsbüros weltweit (ohne Europa)*

*ohne International Rectifier



United Nations Global Compact 10 Prinzipien

Menschenrechte

- Prinzip 1: Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten
- Prinzip 2: Sicherstellen, dass Sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen

Arbeitsnormen

- Prinzip 3: die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren
- Prinzip 4: sich für die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit einsetzen
- Prinzip 5: sich für die Abschaffung von Kinderarbeit einsetzen
- Prinzip 6: sich für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit einsetzen

Umweltschutz

- Prinzip 7: im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen
- Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern
- Prinzip 9: Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen

Korruptionsbekämpfung

- Prinzip 10: gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung

Corporate Social Responsibility*

Unser Verständnis

CSR bei Infineon umfasst unsere freiwillige Verpflichtung, Aktivitäten sowie Leistungen in den Kategorien:

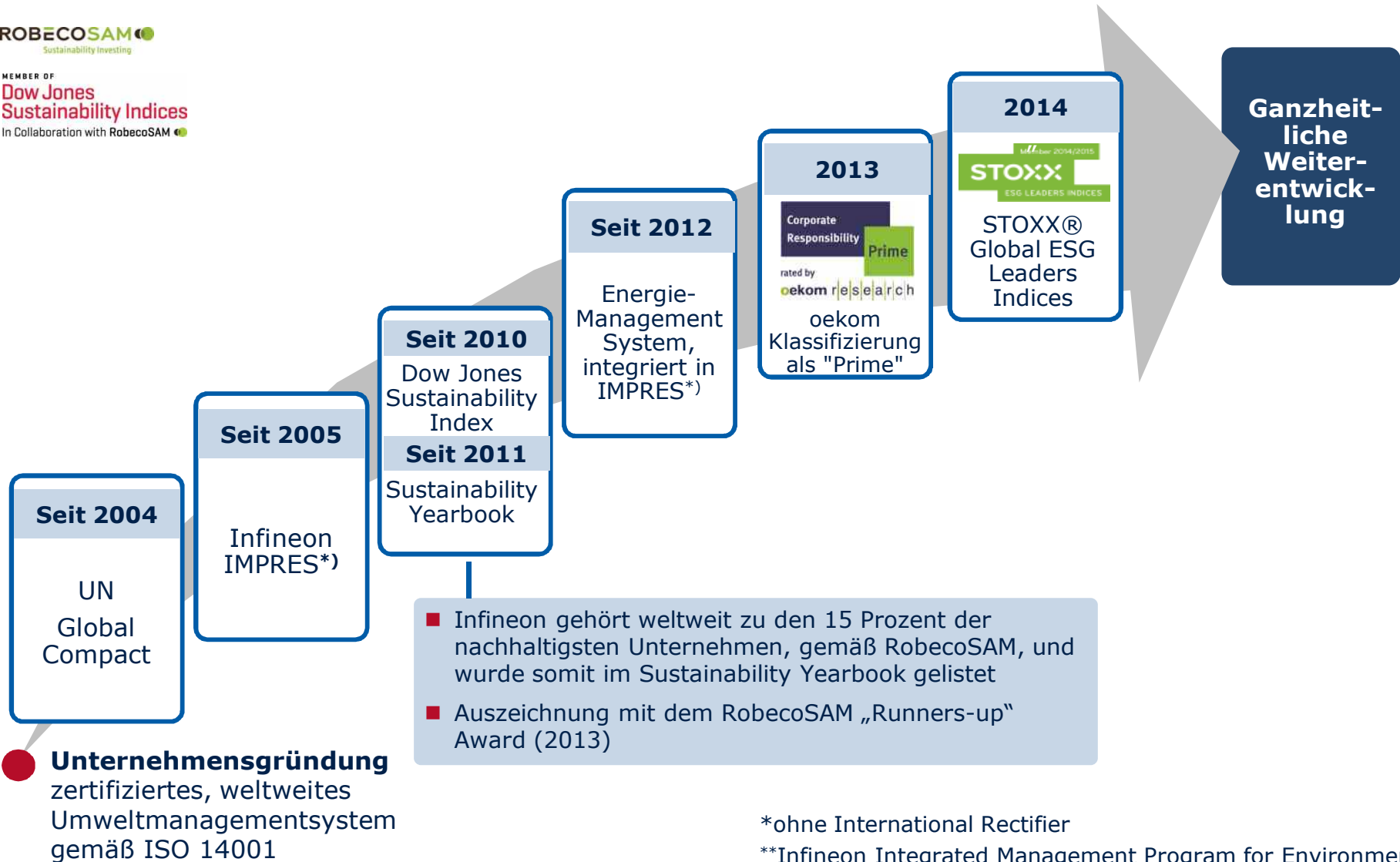


Corporate Social Responsibility*

Erfolgreicher CSR Ansatz

ROBECOSAM
Sustainability Investing

MEMBER OF
**Dow Jones
Sustainability Indices**
In Collaboration with RobecoSAM



Unternehmensgründung
zertifiziertes, weltweites
Umweltmanagementsystem
gemäß ISO 14001

*ohne International Rectifier

**Infineon Integrated Management Program for Environment, Energy, Safety and Health (Energie seit 2012)

Zertifizierungen

Basierend auf unseren Leistungen in den Bereichen des Ressourcenmanagements, im Gesundheitsschutz sowie der Arbeitssicherheit erhielt Infineon die EN ISO 14001, OHSAS 18001 und ISO 50001** Matrixzertifizierung.

- Infineon verbraucht etwa **20% weniger Wasser** pro cm² produziertem Wafer als der globale Durchschnitt¹⁾.
- Infineon verbraucht etwa **32% weniger Elektrizität** pro cm² produziertem Wafer als der globale Durchschnitt¹⁾.
- Infineon verursacht etwa **47% weniger Abfall** pro cm² produziertem Wafer als der globale Durchschnitt¹⁾.



*ohne International Rectifier

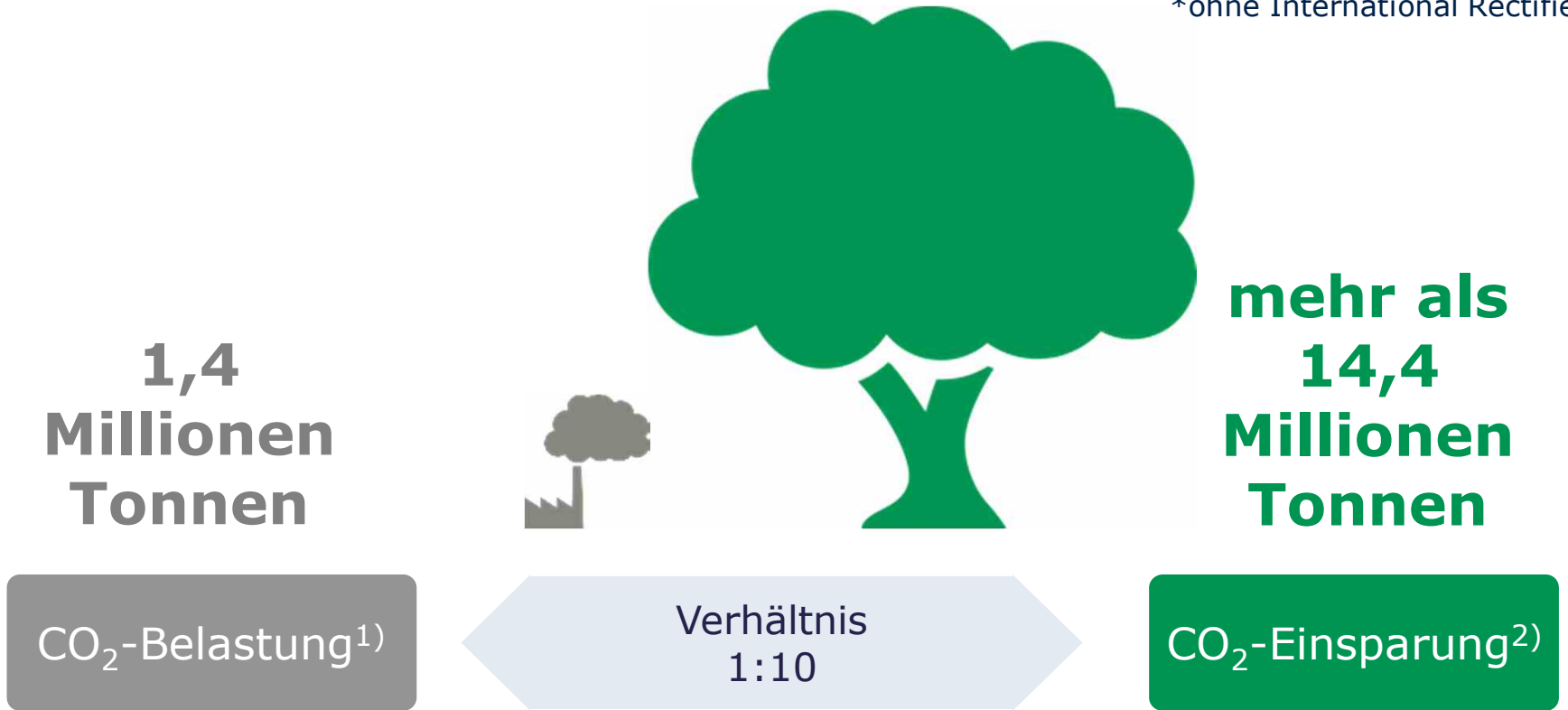
** ISO 50001 wesentliche EU Standorte

1) Gemäß "World Semiconductor Council"

Unsere CO₂-Bilanz: Reduzierte Emissionen durch unsere Produkte und Lösungen*



*ohne International Rectifier



**Ökologischer Nettonutzen*:
CO₂-Reduktion von rund als 13 Millionen Tonnen**

1) Die Kennzahl berücksichtigt Produktion, Transport, Fahrzeuge für dienstliche Belange sowie Flugreisen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Chemikalien, Wasser/Abwasser, direkte Emissionen, Energieverbrauch, Abfall usw. Sie basiert auf intern erhobenen Daten und öffentlich verfügbaren Umrechnungsfaktoren und bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2014*.
2) Die Ermittlung der Kennzahl erfolgt auf Basis selbst entwickelter Kriterien, die in den begleitenden Erläuterungen detaillierter erklärt werden. Die Kennzahl bezieht sich auf das Kalenderjahr 2013 und wird für folgende Bereiche erhoben: Automobil, Lampenvorschaltgeräte, PC-Stromversorgungen, erneuerbare Energie (Wind, Fotovoltaik) und Antriebe. Die Berechnungen der CO₂-Einsparungen gründen auf Einsparpotenzialen von Technologien, in denen Halbleiter zum Einsatz kommen. Die Zurechnung eingesparter CO₂-Emissionen erfolgt über den Infineon Marktanteil, den Halbleiteranteil und die Lebensdauer jeweiliger Technologien, die auf internen und externen Expertenschätzungen beruhen. Solche komplexen ökobilanziellen Betrachtungen sind mit Unschärfe und gewissen Unsicherheiten behaftet, das Ergebnis ist jedoch eindeutig.*

Business Continuity Ganzheitliches Management*





ENERGY EFFICIENCY MOBILITY SECURITY

Innovative semiconductor solutions for energy efficiency, mobility and security.

